

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险提示”章节,敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上年度末盈利且尚未实施股利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配现金股利25,246,800.00元(含税)。本年度公司现金分红比例32.64%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见,本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

公司股票简称

适用 不适用

股票代码	股票简称	变更前股票简称	股票简称	股票代码	变更前股票代码
688037	芯源微	芯源微	芯源微	688037	不适用

公司存在控股情况

适用 不适用

联系人及联系方式

联系人姓名及职务	董事会秘书(信息披露负责人)	证券事务代表
姓名	李俊刚	林珊珊
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路46号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路46号
电话	024-23862620	024-23862620
电子邮箱	688037@sigem.com.cn	688037@sigem.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、产品及服务情况

公司主要从事半导体专用设备的研究、生产和销售,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法蚀蚀机),可用于8/12英寸单晶圆制程(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)及6英寸及以下单晶圆处理(如化合物、MEMS、LED芯片制造等环节)。



作为公司标杆产品,光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备,主要与光刻机/芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难度最大、价格最高的设备配合进行作业,通过机械手晶圆组在系统间传输和处理,从而完成晶圆的光刻涂胶、固化、显影、坚膜等工序。作为光刻机的输入/曝光前光刻涂胶层和输出/曝光后图形的显影),涂胶/显影机的性能不仅直接影响到细线曝光图形的形成,其显影工艺的精确性和缺陷控制对后续诸多工艺(诸如蚀刻、离子注入等)中图形转移的效果也有着深远影响。

公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白,其中在集成电路前道晶圆加工环节已获得了多个前道大客户订单及应用,实现小批量销售;在集成电路后道先进封装环节,化合物、MEMS、LED芯片制造等环节,作为国内厂商主流机型已广泛应用于国内知名大厂,成功实现国产替代。

公司在集成电路前道晶圆加工领域单片式清洗设备Spin Scrubber设备已经达到国际先进水平,在国内多个重要客户处获得批量重复订单,成功实现国产替代。

(二)主要经营模式

1. 盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,通过向下游公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售,其他业务收入来源于设备相关配件销售及维修服务。

2. 采购模式

公司主要根据生产订单物料、研发物料、售后服务物料的需求计划和安全库存的需要等确定采购计划,采取与供应商签订合同或订单/年度框架协议等方式开展采购。为保证公司产品的质量和性能,公司对供应商实行统一管理,主要考察供应商的资质实力、产品情况、售后服务等方面,经外部多方调查、样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录,并持续更新及跟踪评级。

3. 研发模式

公司以自主研发为主,充分结合产品技术发展走势及客户实际需求,以核心技术突破、核心产品零部件研发、整机研发及应用并重为原则,确定公司研发方向和研发项目,建立了机械、电气、软件等多模块协同配合、公司级与部门级研发项目相结合的创新发展机制。同时,公司技术人员多负责于研发项目的立项评审,组织下设计开发与任务,开展跟踪管理,逐项验收评价等具体实施管理。

4. 生产模式

公司采用在手订单生产为主,潜在订单预生产为辅的生产模式。公司根据已签合同订单及有明确需求且供货紧张的潜在客户的需求进行产品定制化设计及生产,以满足客户对产品不同技术指标和供货的需求,同时也能合理管控公司在产品的规模和采购风险。

5. 销售模式

公司主要采取“直销为主,代销为辅”的销售模式。直销模式下,公司通过商务谈判、招投标等方式获取订单;委托代理销售模式下,公司与特定地区代理商签订产品销售区域代理协议,由其负责在特定地区代理销售公司产品,公司向其支付一定比例的区域佣金。

公司配备了专业的销售服务团队,主要负责售前客户需求分析、商务谈判或招投标投标及销售后的设备安装、调试、保修、维修、技术培训及客户满意度回访等服务工作,公司始终秉承“客户第一,为客户创造价值”的营销理念,致力于为客户提供“专业精品”的产品及服务。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点
公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“专用设备制造业”(C35);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”(C3562)。

半导体被称为制造业皇冠上的明珠,半导体产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其技术水平和国际竞争力已成为衡量一个国家综合竞争力和综合国力的重要标志之一。作为“工业根基”,半导体行业被广泛应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子、物联网等行业,是绝大多数电子设备的核心组成部分。根据国际货币基金组织预测,每1美元半导体芯片的产能可带动数字经济产业10亿美元产值,并带来100美元的GDP,这种100倍价值链的放大效应奠定了芯片行业在国民经济中的重要地位。为推动半导体产业发展,增强自主创新能力和国际竞争力,带动传统产业改造和产业升级换代,进一步促进国民经济持续、快速、健康发展,我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策的通知》等鼓励和支持半导体产业发展的政策,为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。

从全球半导体设备行业来看,随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长,以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展,集成电路产业面临着新型芯片及先进制程的产能扩张需求,为半导体设备行业带来了广阔的市场空间。根据SEMI2021年12月预测报告,2021年全球半导体设备销售总额达到1030亿美元,同比增长44.7%,系历史上首次突破1000亿美元大关,并将将在2022年继续增长至1140亿美元。其中,半导体前道设备2021年销售额达到880亿美元,同比增长43.7%,并将将在2022年继续增长并保持980-990亿美元左右。SEMI预计,在数字基础设施建设方面的持续投资以及多个终端市场的长期强劲增长将推动半导体设备行业持续发展。

从我国半导体设备行业来看,随着集成电路产业国际产能不断向我国大陆地区转移,我国大陆集成电路生产线建设快速推进,下游晶圆制造厂商持续扩产,各大厂商纷纷布局扩产计划。据SEMI设计,2016-2020年,我国大陆半导体设备市场规模从6.64亿美元增长至187.20亿美元。近五年来市场复合增长率达到30.65%,远高于全球市场增速。2020年,我国大陆半导体设备市场占全球市场的比例从16.07%的15.68%提升到26.20%,成为全球第二大市场。国内半导体设备市场将持续维持高景气度状态,市场前景广阔。

(2)主要技术门槛

公司所处的半导体设备行业属于典型的设备密集型行业,涉及电子、机械、电气、材料、信息等多学科领域,是多种门类学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛。半导体设备行业涉及国家高科技综合实力的比拼,具有技术壁垒高、价值量高、研发周期长等特点。由于半导体工艺复杂度高,对设备依赖程度高,设备性能直接影响半导体制造的产品品质、工艺效率及良率,最终影响到半导体企业的盈利能力和全球竞争力。因此,要实现我国半导体设备自主可控模式的崛起,完成设备环节的国产化是其至关重要的环节之一。目前,以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业仍占据全球半导体设备市场的主要份额。在国内市场和国外国家支持下,我国半导体产业链不断完善,但仍然处在供给能力不足的情况下,我国半导体市场国产替代存在较大市场空间。伴随着国家鼓励政策支持产业发展和投资资金不断的落实与落地,我国半导体设备行业迎来了前所未有的发展机遇,半导体设备的国产化进程不断推进。

以公司生产的涂胶显影设备为例,作为晶圆生产过程中配合光刻机工作的关键工艺设备,其产品结构复杂(包括约二十余个功能模块组及配套设施),单元众多(百余个功能单元),配件繁杂(数万个零部件),同时还需确保平均每小时数千次的机械运转速度。前道涂胶显影设备系高技术高精密机械,温度度及内环境控制,生产调度及控制、化学反应化学药品管控等,是半导体制造领域的现代高科技装备,对生产厂家的技术储备、工艺水平提出了较高要求。此外,影响前道涂胶显影设备实现量产销售的难点还包括客户端工艺验证,需要协助下游晶圆厂,在不影响其生产线正常生产的情况下,提供光刻机、掩膜板、检测专用设备、客户产品等资源配合,验证流程复杂,所需周期较长。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备行业具有较高的技术壁垒,市场壁垒和客户认知壁垒,以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业占据了全球半导体设备市场的主要份额。

集成电路制造前道晶圆加工领域用涂胶显影设备主要被日本东京电子(TEI)所垄断。公司生产的涂胶显影设备通过与客户“端对端”合作,在多个关键技术方面取得突破,技术成果已广泛应用于国内。报告期内,公司生产的前道涂胶显影设备连续获得多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件等其他诸多工艺等多个国内厂商。公司在前道涂胶显影领域,作为国内国产化设备已逐步得到了应用,实现了小批量销售。

集成电路制造前道晶圆加工领域用清洗设备主要被日本迪思士(DNS)等厂商垄断。通过持续的改进、优化,公司生产的集成电路前道晶圆加工领域用清洗机Spin Scrubber设备的各项指标均得到明显改善或提升,已经达到国际先进水平并成功实现国产替代。2020年在国内外多个重点客户处通过验收。2021年获得中芯国际、上海华虹、武汉新芯、厦门士兰微电子、拓克芯源、青岛芯源、上海积塔等国内多家Fab厂的批量重复订单。

公司生产的前道涂胶显影设备和单片式湿法设备作为主流机型已批量应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、中芯国际、中芯宁波等国内一线大厂,目前已经成为客户端的主力生产设备。公司在后道封装持续开拓新客户,报告期内台湾开拓了日月光、啟碁科技、盛合晶微等封装客户。公司在未来拟大力度持续开拓开拓台积电以及海外市场。

截至报告期末,公司生产的应用于各领域的涂胶显影设备和单片式湿法设备已累计销售1400余台套。

3 报告期新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
在前道晶圆加工领域,随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长,以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展,全球晶圆代工行业纷纷启动成熟制程产能扩充计划。

公司代码:688037

公司简称:芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

划,根据SEMI2021年6月发布的《世界晶圆厂预测报告》,全球半导体制造商将在2022年前新建29座高产能晶圆厂,资本支出超1400亿美元。全球晶圆代工龙头台积电在2021年全年资本开支300亿美元,并在2022年指引中上调资本开支至400-440亿美元,同时台积电表示2022年代工行业将增长20%。国内晶圆代工龙头中芯国际2021年资本开支45亿美元,并在2022年指引中表示资本开支将增至50亿美元。根据市场公开信息的不完全统计,中国大陆地区主要晶圆厂预计新增12英寸芯片产能约1,480,200片/月,新增8英寸芯片产能约11,500万片/月,随着国内众多晶圆厂的持续扩产,国内半导体前道设备行业将持续维持高景气度状态,市场前景广阔。

在先进封装领域,随着前道先进制程走向10nm、7nm、5nm,研发生产成本持续走高,良率下降,摩尔定律趋缓,半导体行业逐渐步入后摩尔时代。先进封装技术不仅可以增加产能、提升产品价值,还可以有效降低成本,成为延续摩尔定律的关键。5G、汽车电子及物联网时代的到来,将更多的应用到AIP、SiP等先进封装技术,高端Yole数据,先进封装占比将由2018年的42.1%提高到2024年的49.7%,对应市场规模475亿美元,年复合增长率将达到3%。同时在大国博弈的背景下,半导体行业将长期持续国产替代的主题,随着上游的芯片设计企业选择将订单回流到国内,具备竞争力的封装厂商将实质性受益。封装产业作为我国半导体领域优势最为突出的电子行业之一,随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工产能利用率的提升,先进封装市场有望迎来新一轮的景气周期。

在化合物、MEMS、LED等小尺寸半导体领域,随着5G、IoT物联网时代的来临,以砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的化合物半导体材料有望快速增长。其中,GaAs是手机PA的主要材料,GaN高频性能突出,是5G基站与数据中心器件的关键材料,在5G通信中有重要地位。SiC主要应用于新能源汽车及其配套设施等大功率场景,受新能源汽车等领域的崛起起与光伏发电等“双基建”项目的需求驱动,SiC有望实现快速增长。化合物半导体行业格局内,欧美企业拥有先发优势,海外企业处于行业领先地位,以三安光电为代表的国内化合物半导体厂商正在追赶,华冠微、斯达半导体等传统半导体企业也纷纷布局。据前瞻产业研究院预计,2022年,中国第三代半导体器件市场规模有望达608.21亿元,三年年均复合增长率将达78.4%。在下游需求持续向好以及国内政策大力支持背景下,化合物半导体市场前景广阔。在LED领域,传统LED照明行业产品单价相比前两年已趋于趋缓;其中长期来看,高端产品如Mini/MicroLED、高光效、车用LED、紫外LED/红外LED等新兴应用领域市场渗透率正逐步提升,近期MiniLED市场出现大幅增长,未来MiniLED作为新一代背光/显示方案有望快速渗透,市场规模迅速提升,将成为LED芯片制造三大主流的产品方向。

作为国内涂胶显影设备和单片式湿法设备提供商,公司产品在前道涂胶显影领域已实现了小批量替代,在前道制程清洗领域已经达到国际先进水平并成功实现国产替代,后道先进封装以及化合物、MEMS、LED芯片制造领域已作为主力量产产能在国内多家一线大厂实现批量应用,公司将继续把握市场发展机遇,持续推进国产设备的加速替代。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,980,914,071.68	1,224,599,820.27	60.13	931,116,076.19
归属于上市公司股东净资产	897,248,076.62	796,597,040.69	12.36	764,486,327.94
营业收入	828,672,512.29	329,300,260.07	151.96	213,166,680.17
归属于上市公司股东净利润	77,349,494.43	48,828,560.01	58.41	29,205,365.56
归属于上市公司股东扣非净利润	63,836,961.51	12,676,142.26	396.53	14,302,697.22
经营活动产生的现金流量净额	-218,239,429.94	-72,389,946.01	不适用	12,234,962.89
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.31	增加0.02个百分点	12.48
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	减少0.01元	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	减少0.01元	0.66
研发投入占营业收入比例(%)	11.16	13.81	减少2.65个百分点	16.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	113,410,936.97	237,497,103.32	196,278,862.29	186,485,617.71
归属于上市公司股东净利润	6,504,246.57	28,568,693.18	18,016,220.26	24,263,326.63
归属于上市公司股东扣非净利润	4,610,211.80	24,906,888.01	16,315,196.90	17,946,064.80
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,154.74	-19,428,394.85	-66,304,730.41	-12,942,150.04

3.3 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	113,410,936.97	237,497,103.32	196,278,862.29	186,485,617.71
归属于上市公司股东净利润	6,504,246.57	28,568,693.18	18,016,220.26	24,263,326.63
归属于上市公司股东扣非净利润	4,610,211.80	24,906,888.01	16,315,196.90	17,946,064.80
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,154.74	-19,428,394.85	-66,304,730.41	-12,942,150.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东人数及前10名股东持股数

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,969
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	0,168
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东人数	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东人数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结		股东类型
					股份数量	数量	
先进封装集成电路技术产业基金(有限合伙)	0	14,322,430	77.03	14,322,430	14,322,430	无	境内非国有法人
中国科学院长春应用光物理研究所	0	10,500,000	12.48	10,500,000	10,500,000	无	境内法人
辽宁科发实业股份有限公司	0	9,932,420	11.80	9,932,420	9,932,420	无	境内法人
中国科学院长春应用光物理研究所	0	2,850,000	6.08	0	0	无	境内法人
福源隆	-1,041,388	2,974,750	3.53	0	0	无	境内自然人
中国科学院长春应用光物理研究所	0	2,850,000	3.15	2,850,000	2,850,000	无	境内非国有法人
国科瑞源物联网装备科技股份有限公司	-2,810,000	1,000,000	2.01	0	0	无	境内非国有法人
李俊刚	0	1,400,000	1.66	1,400,000	1,400,000	无	境内自然人
国科瑞源物联网装备科技股份有限公司	1,100,000	1,100,000	1.31	0	0	其他	其他
中国工商银行股份有限公司-恒安基金中证半导体产业基金	1,078,303	1,078,303	1.28	0	0	无	其他

上述股东无关联关系或一致行动关系的说明

上述股东中,中国科发实业股份有限公司与国科瑞源物联网装备科技股份有限公司存在关联关系,中国科发实业股份有限公司未直接或间接持有芯源微股份,中国科发实业股份有限公司未与芯源微股份存在一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

适用 不适用

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,2021年度,公司实现营业收入82,862.75亿元,实现净利润7,734.95亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2022-013

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一 募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况
经中国证监会上市公司监管部备案,并经上海证券交易所同意,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)121,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币26.97元,募集资金总额为人民币3,269,370,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,826,292.22元,实际募集资金净额为人民币3,208,543,707.78元。已于2021年12月10日到位,募集资金到位情况已经经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具会验字[2019]0294号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
2021年度,本公司募集资金使用情况为:1)对募集资金投资项目投入2,229,659,729.64元,其中:高端晶圆处理设备产业化项目153,233,358.67元,高端晶圆处理设备研发中心项目76,426,370.97元;2)使用闲置资金永久补充流动资金38,300,000.00元;3)使用闲置资金暂时补充流动资金60,000,000.00元。2021年度公司累计使用募集资金327,969,729.64元,支付银行手续费(不含增值税)10,121.39元,募集资金专户银行利息收入为5,967,950.13元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益766,335.62元,募集资金专户账户2021年12月31日余额合计为52,439,742.40元。具体明细如下:

项目	金额
募集资金净额	3,208,543,707.78
截至2021年12月31日直接对募集资金投资项目投入	2,229,659,729.64
其中:高端晶圆处理设备产业化项目	1,987,057,399.33
高端晶圆处理设备研发中心项目	138,599,429.29
截至2021年12月31日使用闲置资金永久补充流动资金	38,300,000.00
截至2021年12月31日使用闲置资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
截至2021年12月31日募集资金管理收益	11,509,603.96
加:截至2021年12月31日募集资金利息收入扣除手续费净额	9,942,472.66
募集资金余额	52,439,742.40

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2021年12月11日,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城阳支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行和时存银行机构国信证券设备股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2019年12月11日在中信银行沈阳和平支行开设募集资金专项账户(账号812